

精密・電子事業カンパニー 総合製品カタログ

※ カタログ中「〇〇〇型」の表示は当社の登録記号です。

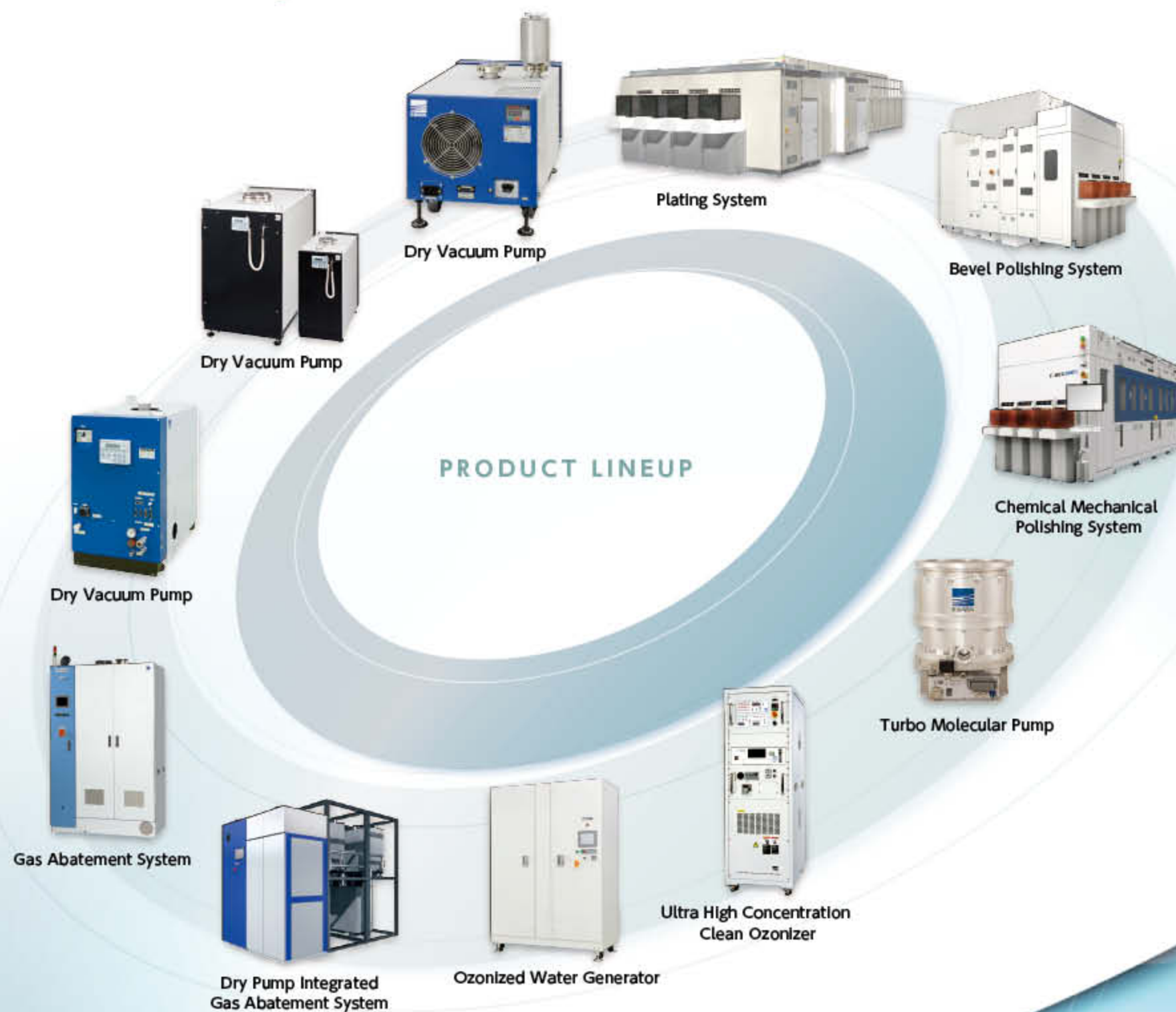
Globally Positioned
Regionally Connected

Looking ahead, going beyond expectations

Ahead Beyond

目次 index

ドライ真空ポンプ EV-S型	2
ドライ真空ポンプ EV-L型	3
ドライ真空ポンプ EV-M型	4
ドライ真空ポンプ EST型	5
ドライ真空ポンプ ESA型	6
ドライ真空ポンプ EV-SA型	7
ドライ真空ポンプ EV-A型	8
ドライ真空ポンプ EV-PA型	9
ターボ分子ポンプ EMT/EBT型	10
真空機器集中監視システム EBANET3	11
排ガス処理装置 TND型	12
排ガス処理装置 G5型	13
大流量排ガス処理装置 G5型	14
排ガス処理装置 G6-E型	15
排ガス処理装置 FDS型	16
ドライ真空ポンプ+排ガス処理装置一体型システム	17
超高濃度クリーンオゾナイザ OZC型	18
オゾン水製造装置 OZW型	19
CMP装置 F-REX型	20
めっき装置 UFP型	21
ベベル研磨装置 EAC型	22



EV-S型 : ドライ真空ポンプ

Dry Vacuum Pump

ロードロック室・SEM等軽負荷用途から腐食性プロセスまでの幅広いアプリケーションを対象とし、排気速度可変機能・通信機能等の付加価値をそのままに、省エネルギー・省スペース・軽量化を更に追求した独立設置対応用ルーツ型ドライポンプです。



■ 特 長

- 業界最高水準の省エネルギー・省スペース・軽量化を実現
- 耐腐食性材料モデル・N₂パージモデルの選択可能
- 周波数(50/60Hz)にかかわらず同一性能
- 充実したセンシング機能でダウンタイムを低減

型 式	EV-S20(P/N)	EV-S50(P/N)	EV-S100(P/N)	EV-S200(P/N)
最大排気速度(L/min)	1,670	5,000	10,000	20,000
消費電力(到達圧力時)(kW)*	0.4	0.55	0.65	0.75
外形寸法(W×D×H mm)	230×450×274	230×450×520	260×510×520	275×650×580
質量(kg)	60	100	120	170

*N₂パージ無し時の値

EV-L型 : ドライ真空ポンプ

Dry Vacuum Pump

エバラ独自の省エネ技術を踏襲しながら、多様な温度制御オプションによって高温化運転が実現できるドライ真空ポンプです。高温運転の実現により、エッチング、プラズマCVD等、反応性生成物が懸念となるプロセスを含む、幅広い用途でご使用いただくことが可能です。



■ 特 長

- プロセス特性に応じた多彩なヒートアップオプションによる幅広いプロセスカバレッジ
- 耐腐食性材料の標準採用に加え、更なる耐食性向上オプションをラインナップ
- 周波数(50/60Hz)にかかわらず同一性能
- 用途に応じた回転速度調整による更なる省エネ効果

型 式	EV-L20N	EV-L100N	EV-L200N
最大排気速度(L/min)	2,000	10,000	18,000
消費電力(到達圧力時)(kW)	0.65	0.9	1
外形寸法(W×D×H mm)	280×635×320	380×647×655	380×772×655
質量(kg)	75	150	200

EV-M型 : ドライ真空ポンプ

Dry Vacuum Pump

半導体・液晶・太陽電池セル製造工程の中で、反応副生成物が発生する高負荷プロセスに対応し、ダウンタイム抑制とランニングコスト低減のご要望にも十分お応えできる次世代ドライ真空ポンプです。
高負荷プロセス対応と省エネルギー性という、相反する条件を高いレベルで両立させました。



■ 特 長

- プロセス条件・排気速度に応じた豊富な製品ラインナップ
- 高負荷プロセス対応と消費電力低減の両立を高次元で実現
- 腐食性ガスに対応 (耐食材料を標準採用)

型 式	EV-M20N	EV-M102N	EV-M202N	EV-M302N	EV-M502N	EV-M802N
最大排気速度 (L/min)	1,800	10,000	20,000	30,000	50,000	80,000
消費電力 (到達圧力時) (kW)	1.2	1.8	1.9	2.3	2.1	2.8
外形寸法 (W×D×H mm)	370×770×450	380×790×752	380×820×752	380×910×830	485×975×870	630×1,000×1,030
質量 (kg)	170	320	360	400	500	740

EST型 : ドライ真空ポンプ

Dry Vacuum Pump

反応副生成物が形成されるCVD等向けにスクリー型ロータを採用し、許容流入ガス量増大・耐食性能・排気速度可変機能・通信機能等の付加価値を実現した独立設置型ドライポンプです。



■ 特 長

- 反応副生成物形成プロセスに最適 (ポンプ内ガス温度の高温保持)
- 大排気速度・許容大流入ガス量を実現
- 回転速度自動制御機能装備 (流入ガス流量に順応)
- 腐食性ガスに対応 (耐食材料を標準採用)
- 高性能通信機能搭載
- ポンプ高度制御方式採用 (データ保持機能・アラーム履歴細分化)

型 式	EST10N	EST25N	EST100WN	EST200WN	EST300WN	EST500WN
最大排気速度 (L/min)	1,000	2,500	10,000	20,000	30,000	50,000

ESA型 : ドライ真空ポンプ

Dry Vacuum Pump

LCDスパッタ装置・真空乾燥プロセス・大型ロードロック室等の高速排気性能に優れ、ガス負荷に応じた回転速度自動制御機能・通信機能等の付加価値を搭載した独立設置型ドライポンプです。



■ 特 長

- 大型真空チャンバの高速排気用途に最適
- 回転速度自動制御機能装備
(ポンプへの負荷に順応)
- 有機溶剤排気用の特別仕様オプションも選択可能
- 高性能通信機能搭載
- ポンプ高度制御方式採用
(データ保持機能・アラーム履歴細分化)

型 式	ESA15-D	ESA25-D	ESA25XW	ESA70W(-D) ESA70WN(-D)	ESA80W-HDF ESA80WN-HDF	ESA100W ESA100WN
最大排気速度 (L/min) (50Hz/60Hz)	1,400/1,700	2,500/3,000	5,000/6,000	7,000/8,400	8,400 ※1	10,000 ※1
アプリケーション	MO-CVD・大型ロードロック・その他クリーン真空排気等					

型 式	ESA200W	ESA300W	ESA500W	ESA700W
最大排気速度 (L/min) (50Hz/60Hz)	20,000 ※1	28,000/30,000	47,000/50,000	80,000 ※1
アプリケーション	大型ロードロック・クリーン真空排気等			

※1: 50Hz/60Hz共通排気速度

EV-SA型 : ドライ真空ポンプ

Dry Vacuum Pump

冷却水不要で設置が容易な小形空冷式ドライ真空ポンプです。低消費電力、低騒音を特長とし、各種分析機器や電子顕微鏡等のクリーンな排気用途に最適なポンプです。



■ 特 長

- 小形空冷ポンプ
- 低騒音、低消費電力
- 必要ユーティリティは電源のみで設置の自由度が高い
- CEマーキング、NRTLの海外規格にも対応

型 式	EV-SA20	EV-SA30
最大排気速度 (L/min)	1,670	3,300
消費電力(到達圧力時) (kW)	0.45	0.45
外形寸法 (W×D×H mm)	324×584×347	356×713×347
質量(kg)	65	90
到達圧力(Pa)	ガスバラスト: OFF	3.0
	ガスバラスト: ON	5.0

EV-A10型 : ドライ真空ポンプ

Dry Vacuum Pump

冷却水不要で設置が容易な小形空冷式ドライ真空ポンプです。
大気圧付近の排気速度特性に優れ、ロードロック室等の大気-真空の繰り返し排気をはじめ、幅広い用途に対応しています。



EV-PA型 : ドライ真空ポンプ

Dry Vacuum Pump

小形・軽量・省エネルギー志向のクリーン用途向け空冷ドライ真空ポンプです。
非接触式シールの採用によって長寿命を実現、設置が容易なポータブル設計のプラグ&ラン型新世代ドライ真空ポンプです。



■ 特 長

- 一般真空排気用小形空冷ポンプ
- 大気引きに適した排気速度特性の1,000L/minモデル
- 必要ユーティリティは電源だけで設置の自由度が高い
- CEマーキング、NRTLの海外規格にも対応

型 式	EV-A10
最大排気速度 (L/min)	最大 1,000
	大気圧付近 800
外形寸法 (W×D×H mm)	317×544×344
質量 (kg)	75
到達圧力 (Pa)	ガスバラスト:OFF 1.0
	ガスバラスト:ON 2.0

■ 特 長

- 小形、軽量
- 空冷式/オイルフリー/プラグ&ラン
- 非接触式シールの採用によって、シール交換不要で長寿命

型 式	EV-PA50	EV-PA250	EV-PA500
最大排気速度 (L/min)	50 (36)	230 (200)	500 (430)
消費電力 (到達圧力時) (W)	230 (230)	240 (380)	270 (600)
外形寸法 (W×D×H mm)	175×238×192	189×482×253	189×482×272
質量 (kg)	9	16	21
到達圧力 (Pa)	20 (200)	0.5 (2.0)	

※ガスバラスト有りの場合は ()

EMT/EBT型 : ターボ分子ポンプ

Turbo Molecular Pump

■ 特 長

■ EMT型(磁気軸受型)

- 磁気浮上仕様
- 340~3,300L/sまでの幅広い製品ラインナップ
- コントローラー体型 (EMT2200MK型、EMT3300MK型)
- 空冷型と水冷型を選択可能 (EMT2200MK型、EMT3300MK型を除く)
- 高温仕様、耐食仕様を選択可能 (オプション)
- 様々な特殊仕様をラインナップ (反応生成物対応、極低振動型)
- 取付姿勢自由
- ネットワーク接続対応
- CEマーキング、SEMI S2、NRTLに適合



■ コントローラー別置型

型 式	EMT397M	EMT427M	EMT907M	EMT1307M	EMT2400M
最大排気速度 (N ₂ , L/s)	340	400	900	1,300	2,400

■ コントローラー体型

型 式	EMT1700MK	EMT2200MK	EMT3300MK	EMT3400MK	EMT3800MK	EMT4200MK
最大排気速度 (N ₂ , L/s)	1,650	2,200	3,300	3,300	3,600	4,200

■ EBT型(玉軸受型)

- グリス潤滑玉軸受タイプ
- 70~2,400L/sまでの幅広い製品ラインナップ
- 小形・軽量・低コスト
- コントローラー体型も選択可能 (EBT70型、EBT240型のみ対応)
- 高い耐衝撃性
- 空冷型と水冷型を選択可能 (EBT70F型、EBT240F型は空冷のみ)
- 取付姿勢自由
- ネットワーク接続対応
- CEマーキング、SEMI S2、NRTLに適合

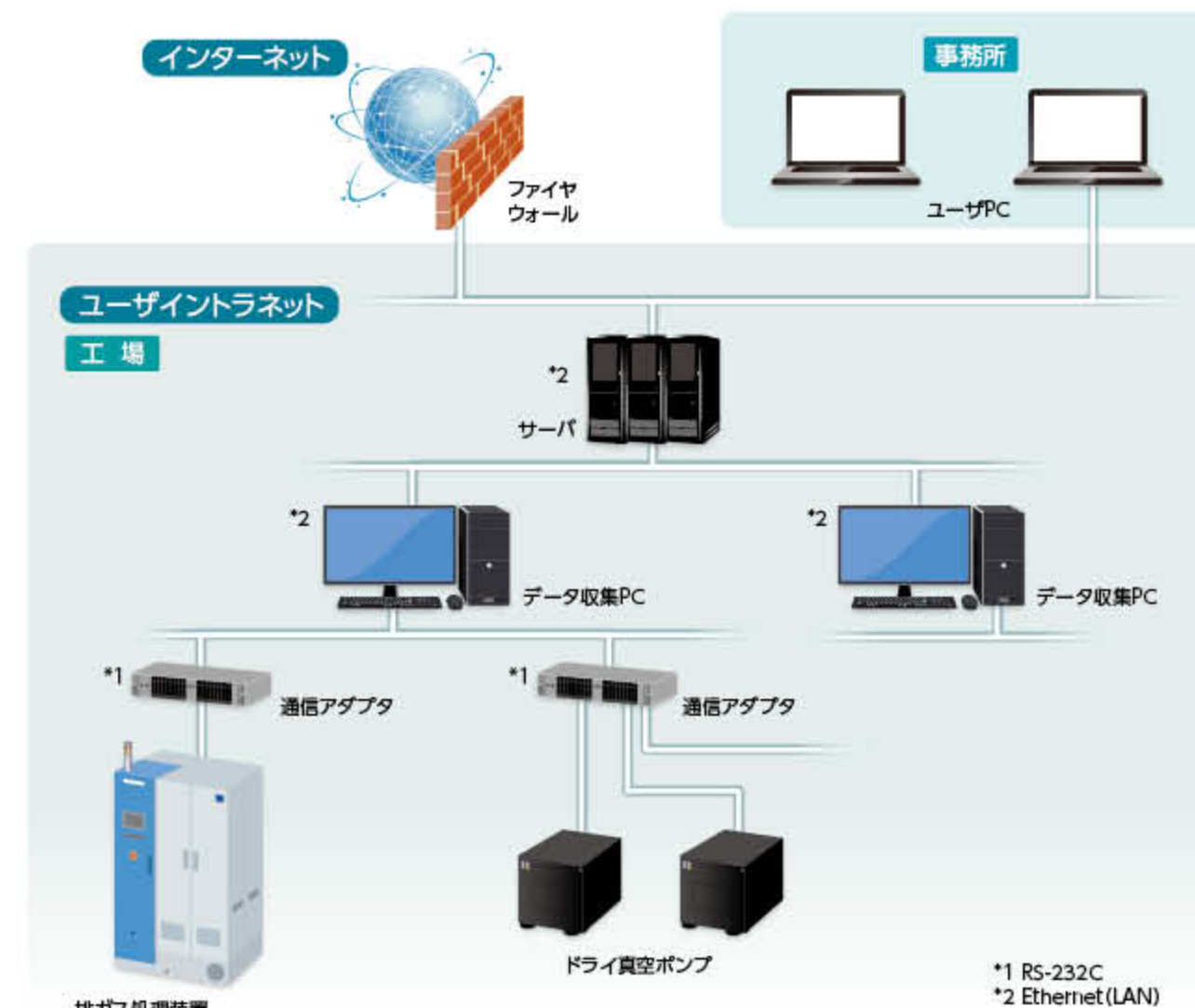


型 式	EBT70F	EBT220F	EBT240F	EBT350F	EBT450F	EBT800F	EBT1100F	EBT1400F	EBT2400F
最大排気速度 (N ₂ , L/s)	70	220	240	330	450	820	1,100	1,400	2,400

EBANET3 : 真空機器集中監視システム

Central Monitoring System

真空ポンプや排ガス処理装置など、排気系全体を遠隔集中監視するシステムです。高速通信・大容量データベース保持機能などを実現し、装置や真空機器、排ガス処理装置のダウンタイム低減に貢献します。



■ 特 長

- ユーザの社内LANに接続すれば、通常PCでWebブラウザによって機器を監視可能
- 通信速度・保存容量の大幅UPによって、秒間隔のデータ保存が可能
- 運転状態や故障状態の監視及び保存が可能
- 一定日数ごとに全機器の故障履歴、運転状況を出力するレポート機能
- 1システムで監視対象機器を最大1,200台まで接続可能 (ドライポンプ換算)
- 警報発生時に担当ユーザへ電子メールで連絡 (オプション)

TND型 排ガス処理装置

Gas Abatement System

TND-Single型/TND-Single Plus型は、荏原独自の燃焼方式を採用した新型バーナーを搭載し、PFCガスを含む各種排ガスの高効率処理を実現。各種腐食・生成物対策により、メンテナンスインターバルを大幅に長期化しました。



G5型 排ガス処理装置

Gas Abatement System

排ガス処理性能・安全性・長寿命化等、当社の排ガス処理技術をベースに、最大ガス流入量350L/minと500L/minの2種類をラインナップし、メンテナンス性を大幅に向上させた燃焼式排ガス処理装置です。



■ 特 長

- 独自の燃焼方式により、高効率排ガス処理と低NOx, 低CO排出を実現
- 消費ユーティリティが少ない低ランニングコスト設計
- 腐食・生成物対策による、従来製品比3倍以上のメンテナンスインターバル*
- プロセスガスとクリーニングガスを同時処理可能
- 燃焼式+水スクラバー(Burn-Wet)のTND-Single型と前段洗浄+燃焼式+水スクラバー(Wet-Burn-Wet)のTND-Single Plusの2機種をラインナップ

*プロセスにより異なる場合があります

型 式	TND-Single-A1~A4	TND-Single-P1~P4	TND-Single Plus-A1~A2	TND-Single Plus-P1~P2
外形寸法(W×D×H mm)	1,200×650×1,980			
ガス流入口数	1~4		1~2	
燃 料	都市ガス仕様(CH ₄)	プロパンガス仕様(C ₃ H ₈)	都市ガス仕様(CH ₄)	プロパンガス仕様(C ₃ H ₈)
最大ガス流入量(L/min)	200(1流入口当たり)		400(1除害装置当たり)	

■ 特 長

- 可燃性・活性・不活性ガスの処理に最適(特別管理物質を除く)
- プロセスガスとクリーニングガスを同時処理可能
- PFCsガスを含む地球温暖化ガスを高効率で分解処理可能
- 低ランニングコスト(処理対象ガスに応じて燃料供給量可変)
- 高アップタイムとメンテナンス性の大幅向上(自動スクレーパ、流水水壁構造など)
- 各種安全対策基準装備

型 式	G5-350-A1 ~ A4	G5-500-A1 ~ A4	G5-350-P1 ~ P4	G5-500-P1 ~ P4
外形寸法(W×D×H mm)	1,200×650×1,900			
ガス流入口数	1~4		1~4	
燃 料	都市ガス仕様(CH ₄)		プロパンガス仕様(C ₃ H ₈)	
最大ガス流入量(L/min)	350	500	350	500

G5型 大流量排ガス処理装置

Gas Abatement System

排ガス処理性能・安全性・長寿命化等、当社の排ガス処理技能をベースに最大ガス流量600L/minと1200L/minの2種類をラインナップし、半導体製造工程において、TEOSなどSi源をとまなう可燃性ガスの大流量排ガス処理に適した燃焼式排ガス処理装置です。



G6-E型 排ガス処理装置

Gas Abatement System

半導体製造工程における、エピタキシャル成長装置等に使用される大流量水素及び塩素を含んだ排ガス処理に適した燃焼式排ガス処理装置です。



■ 特 長

- G5型に更なる大流量仕様をラインナップ
- ガス流入口数を最大4本から6本に
- 高稼働率を実現する副生成物除去機能を標準装備 (バーナー部)
- 粉体自動排出機能標準装備 (タンク部) によって、大幅にメンテナンスインターバルを延長
- 処理対象ガス種・量に応じたオンデマンド運転 (ユーティリティの自動可変) によって、低ランニングコスト化を実現

型 式	G5-600-A1 ~ A6	G5-1200-A1 ~ A6	G5-600-P1 ~ P6	G5-1200-P1 ~ P6
外形寸法 (W×D×H mm)	1,200 x 1,100 x 2,200			
ガス流入口数	1~6		1~6	
燃 料	都市ガス仕様(CH ₄)		プロパンガス仕様(C ₃ H ₈)	
最大ガス流入量 (L/min)	600	1200	600	1200

■ 特 長

- エピタキシャル成長用プロセスガス処理に適したコンパクト設計
- 大流量水素ガスと大流量塩素ガスの同時処理可能、かつ許容流入ガス量として最大400L/minまで流入可能
- 高稼働率を実現する副生成物除去機能を標準装備

型 式	G6-E-A1	G6-E-A2	G6-E-A3	G6-E-A4	G6-E-P1	G6-E-P2	G6-E-P3	G6-E-P4
外形寸法(W×D×H mm)	1,200×650×1,900							
ガス流入口数	1	2	3	4	1	2	3	4
燃料	都市ガス仕様 (LNG)				プロパン仕様 (LPG)			
最大ガス流入量(L/min)	400							

FDS型 排ガス処理装置

Gas Abatement System

半導体酸化膜エッチャー等で使用される難分解性PFCsガスを、熱分解技術と特殊化学吸着作用によってF系ガスを補足し高効率にPFCsガス処理を行います。燃焼式やヒータ式・プラズマ式と違い、フッ酸排水処理の必要がないため、設備負荷が少ない環境対応製品です。



■ 特 長

- PFCs分解後のF系ガスを乾式固定するため排水処理が不要
- 最大流入ガス量250L/minで除去効率99%以上 (250L/min 二筒式の場合)
- 250L/min二筒式：反応槽シリアルフロー設計によって装置アップタイム大幅向上
- 100L/min一筒式：既設乾式排ガス装置から置換えが容易

型 式	FDS100S	FDS250 *
外形寸法(W×D×H mm)	600×600×2,000	1,520×1,000×2,150
反応槽(本)	1	2
最大ガス流入量(L/min)	100	250

■ 対象ガスと処理能力

CF ₄	SiF ₄	NF ₃
C ₂ F ₄	CHF ₃	HF, F ₂
C ₂ F ₆	CH ₂ F ₂	PF ₃
C ₃ F ₆	CH ₃ F	BF ₃
C ₃ F ₈	OF ₂	WF ₆
C ₄ F ₆	XeF ₂	TaF ₅
C ₄ F ₈	SF ₆	SO ₂ F ₂
C ₅ F ₈	CO	

処理対象ガス	最大流入ガス濃度	流出ガス濃度
PFCs	1.0%	50ppm as CF ₄ 以下 (反応槽交換基準値)
CO	2.0%	25ppm (TLV-TWA 値) 以下
SiF ₄	2.0%	0.5ppm as HF (TLV-TWA 値) 以下

※【リスト規制該当品】
本製品は「輸出貿易管理令に掲載の貨物」に該当します。
輸出する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。

ドライ真空ポンプ＋排ガス処理装置一体型システム

Dry Pump Integrated Gas Abatement System

当社ドライ真空ポンプと排ガス処理装置の統合製品です。
お客様の設備レイアウトに最適なカスタム設計を行います。

■ 特 長

- エバラ独自のドライポンプ組込型排ガス処理システム
- 最適なドライポンプと組み合わせ、設備設置負荷低減
- 統合排気システムとして一括操作・一括管理を実現
- ポンプ接続台数：1～8台
- 対象ドライポンプ：EV-S型/ESR型/EST型/EV-M型/ESA型
- 対象排ガス処理装置：G5型/GT型



設備レイアウトに合わせたカスタムラック構造で
設置面積とメンテナンススペースを低減



- 横置1段仕様
30,000L/min以上のポンプに適用



- 横置2段積み仕様
30,000L/min未満のポンプに適用



- ポンプ交換時のリフト
専用リフトで安全・短時間作業

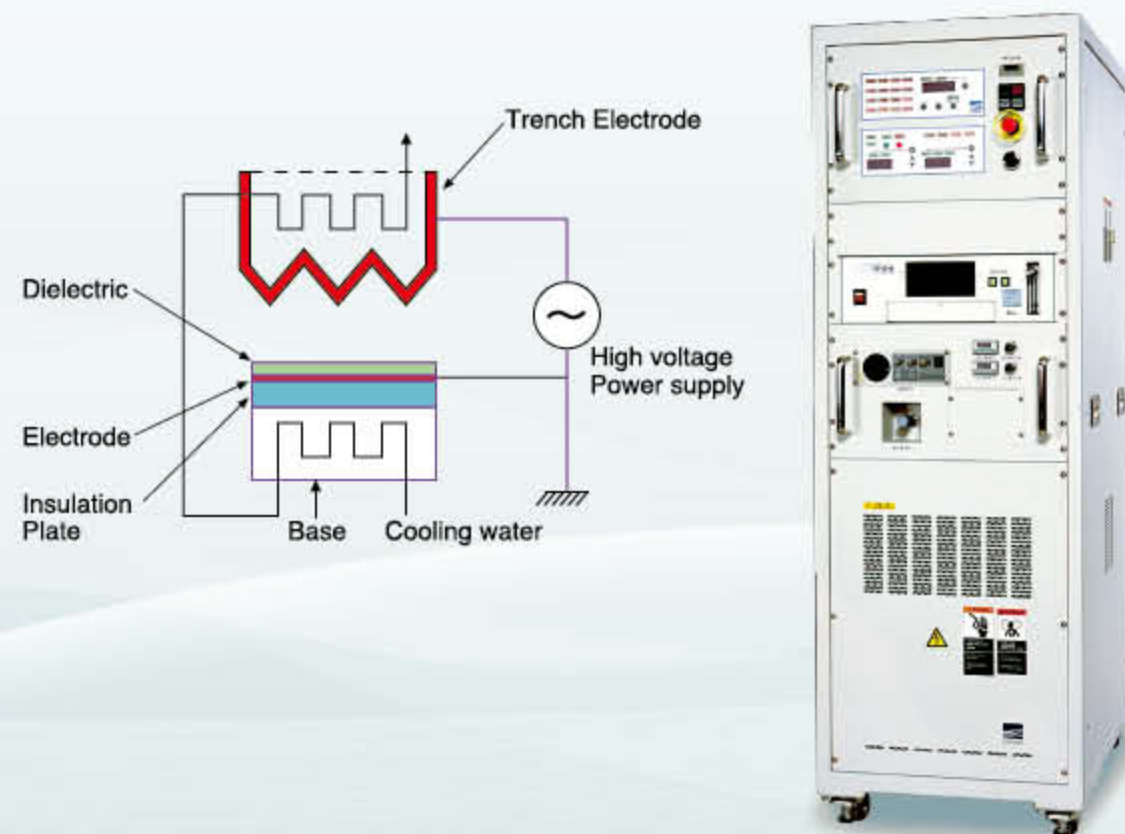
カスタム設計製品につき詳細仕様は弊社営業までお問合せください。

○ZC型 : 超高濃度クリーンオゾナイザ

Ultra High Concentration Clean Ozonizer

エバラ独自の放電原理によるオゾナイザです。

無声放電と沿面放電の複合放電によって超高濃度オゾンを生じます。

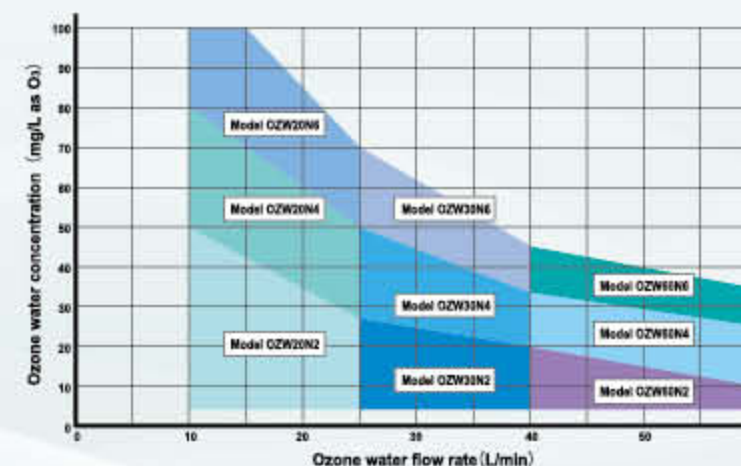


○ZW型 : オゾン水製造装置

Ozonized Water Generator

クリーンオゾナイザ (OZC型)、低汚染型加圧ポンプ、新開発のオゾン溶解方式を組み合わせることによって、次世代ウェットプロセス対応のクリーンなオゾン水を連続供給できる装置です。

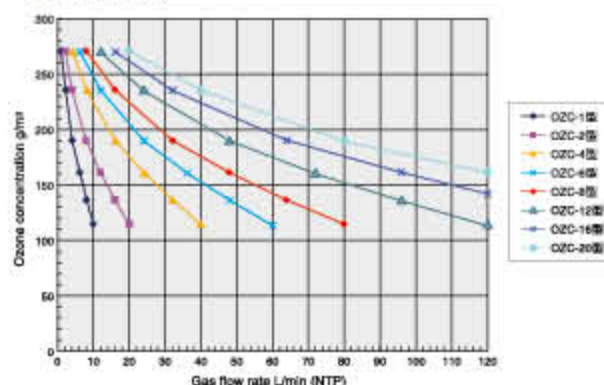
●性能範囲



■特長

- 超高濃度 (10vol %以上)・大流量のオゾンを生じ安定して発生
- 電極にセラミックコーティングと誘電体にサファイアを採用し、超クリーンオゾンの発生を実現
- 飛躍的に大きな単体面積当たりのオゾン発生量によって、オゾナイザの小形化を達成
- オゾン漏れセンサを標準装備

●性能曲線



■特長

- 新開発オゾン溶解方式
従来のフッ素樹脂製溶解膜に替えて、新開発のオゾン溶解ユニットによる直接溶解方式を採用しました。当社従来型と比べランニングコスト及びフットプリントの低減を実現しています。
- 不純物のないオゾン水
新オゾン溶解ユニット、荏原クリーンオゾナイザ (OZC型)、低汚染型加圧ポンプによって、TOC (Total Organic Carbon)、金属不純物の混入を抑えたクリーンなオゾン水を提供可能です。
- 優れた濃度・流量安定性
オゾン水濃度を常時計測してフィードバック制御することによって、安定してオゾン水濃度を保つことができます。また、無段階可変速型加圧ポンプによって、洗浄装置とオゾン装置に高低差がある場合でも、安定したオゾン水の供給が可能です。
- 操作の容易性、安全性、信頼性を備えた装置
洗浄装置と組み合わせて運転できるよう、連続運転信号、インタロック信号を装備しており、装置の機器もメンテナンスが容易な構成となっております。また、異常発生時には安全に装置を停止するための安全回路も装備しております。(CE/SEMI対応)
- 脱気・ガス溶解システム
エバラ脱気水製造装置、エバラガス溶解水製造装置 (H₂, N₂, CO₂) と組み合わせることによって、より高度な機能水の供給が可能です。

* [リスト規制該当品] 本製品は「輸出貿易管理令に掲載の貨物」に該当します。輸出する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。

F-REX型 : CMP装置

Chemical Mechanical Polishing System

ウェーハ表面を化学的機械的に研磨するクリーンルーム設置型のCMP装置です。市場で証明された高い信頼性と優れたプロセス性能を有する本装置は、各ユーザーの仕様に対応するようフレキシブルな装置構成が可能です。

エバラが提案する
次世代平坦化プロセスの実現技術です。



■ 特 長

- ドライイン/ドライアウト
- 優れたプロセス性能
- 生産性の向上 (高信頼性、高メンテナンス性など)
- 3段洗浄 (ケミカル洗浄) 対応
- ポリッシュ終点検出モニタ (オプション)
- インライン膜厚測定器 (オプション)
- 1テーブル1ヘッドコンセプトによる高いプロセス信頼性

型 式	F-REX200M2	F-REX300X
トップリング数	2 (200mmウェーハ対応)	4 (300mmウェーハ対応)
ターンテーブル数	2	4
洗浄ユニット数	4	6 or 8

UFP型 : めっき装置

Wafer Plating System

角基板にバンプ、再配線、ビア等の微細パターンを形成させるクリーンルーム設置型の電解めっき装置です。



■ 特 長

- ウェーハめっき装置の経験に基づく角基板専用めっき装置
- お客様の要求に柔軟に対応可能なプラットフォーム
(めっき槽の増減が可能、最大10槽搭載可能)
- 高速めっきと優れた面内均一性の両立
- 反りのある基板、薄いシード層における高性能、高信頼性めっき
- 開発用、量産用の双方において様々なアプリケーションに対応可能
(バンプ、再配線、ビア、ファンアウト等)

型 式	UFP-AS
適用角基板 (mm)	最大 600×600
めっき槽数	4槽 ~ 10槽
用 途	開発用~量産用 (自動機)

EAC型 : ベベル研磨装置

- Bevel Polishing System

半導体ウェーハの端面であるベベル部分やその周辺のエッジ部分、またウェーハ裏面部分を研磨することによって欠陥を除去する装置です。



■ 特 長

- 固定砥粒による卓越した研磨・除去性能
- デバイス面へのコンタクトフリーコンセプト
- ベベル形状プロファイルコントロール機能
- 広範囲・フレキシブルな研磨エリア (デバイス面エッジ〜ベベル〜裏面)

型 式		EAC300bI-hv
構 成	研磨ユニット数	2
	洗浄ユニット数	2
	乾燥ユニット数	2
対象ウェハサイズ		300
外形寸法(W×D×H mm)		2,300×4,220×2,550

MEMO



お客様を支える 精密・電子事業サポートネットワーク

PRODUCT-Plus

事業開始以来、最優先で取り組んできた磐石のサポート体制。
エバラはサポート業務をもうひとつの製品と考えています。

- 技術サポート・設備コンサルタント
- プロセスサポート
- フィールドサポート
- 製品修理・オーバーホール・アップグレード



藤沢事業所
精密・電子事業カンパニー本部



熊本工場



※ FSC: FullSupportCenter(修理工場)
SS: SupportShop(サポートショップ)

Global Network



USA :
Ebara Technologies Inc

- ・本 部: Sacramento(CA)
- ・F S C: Sacramento(CA)
- ・ Hillsboro(OR)
- ・S S: San Jose(CA)
- ・ Albany(NY)
- ・ Newburyport(MA)
- ・ Boise(ID)



EUROPE :
Ebara Precision Machinery Europe GmbH

- ・本 部: Hanau, Germany
- ・F S C: Livingston, UK
- ・ Dresden, Germany
- ・S S: Graz, Austria



KOREA :
Ebara Precision Machinery Korea Inc

- ・本 部: Pyeongtaek
- ・F S C: Pyeongtaek
- ・S S: Seongnam
- ・ Hwasung
- ・ Cheonan
- ・ Icheon
- ・ Cheongju



CHINA :
Shanghai Ebara Precision Machinery Co.,LTD

- ・本 部: Shanghai
- ・F S C: Shanghai
- ・S S: Wuxi
- ・ Dalian
- ・ Beijing
- ・ Wuhan



SINGAPORE :
Ebara Engineering Singapore Pte.Ltd

- ・本 部: Tuas Link
- ・F S C: Tuas Link



TAIWAN :
Ebara Precision Machinery Taiwan Inc

- ・本 部: Taipei
- ・F S C: Hukou
- ・S S: Linkou
- ・ Hsinchu
- ・ Taichung
- ・ Tainan

株式会社 荏原製作所 精密・電子事業カンパニー

〒251-8502 神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1

<https://www.ebara.co.jp>

株式会社 荏原フィールドテック

〒251-8502 神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1 TEL.0466-83-9171

<https://www.eft.ebara.com>

<サポートショップ>

- | | | |
|-------|--------------------------------------|------------------|
| ■北 上 | 〒024-0081 岩手県北上市有田町1-33 | TEL.0197-62-4646 |
| ■東 北 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-5-30 SFI仙台ビル | TEL.022-290-8813 |
| ■山形駐在 | 〒998-0842 山形県酒田市亀ヶ崎7-6-30 | |
| ■東 京 | 〒251-8502 神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1 | TEL.0466-83-8534 |
| ■中 部 | 〒510-8027 三重県四日市市茂福683-1 | TEL.059-361-3101 |
| ■大 阪 | 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ | TEL.06-6452-6990 |
| ■四国駐在 | 〒793-0003 愛媛県西条市ひうち3-61 | TEL.0897-55-1114 |
| ■広 島 | 〒739-0015 広島県東広島市西条栄町10-27 栄町ビルディング | TEL.082-423-0253 |
| ■長 崎 | 〒854-0084 長崎県諫早市真崎町1854-3 | TEL.0957-26-8822 |
| ■熊 本 | 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1592-4 | TEL.096-287-1604 |
| ■大 分 | 〒870-0278 大分県大分市青崎2-5-13 | TEL.097-521-5681 |

<オーバーホール工場>

藤沢・中部(三重、鈴鹿)・九州(熊本)



株式会社 荏原製作所

精密・電子事業カンパニー

〒251-8502 神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1 <https://www.ebara.co.jp>

株式会社 荏原フィールドテック

〒251-8502 神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1 ☎0466-83-9171 <https://www.eft.ebara.com>

- このカタログに掲載した製品は「輸出貿易管理令 別表第1の16項に掲載の貨物」に該当しますので、輸出する場合は「用途」「需要者」などの確認が必要となり、場合によっては経済産業大臣の許可が必要となります(これらの要件確認は輸出者においてご確認ください)また、一部の製品は同管理令 別表第1の1～15項に該当(リスト規制該当品)します。このリスト規制該当品を輸出する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要となりますのでご注意ください。なお、詳細はお近くの弊社の営業所にお問い合わせください。
- ご使用に際しては、取扱説明書に記載の注意事項をよく読み遵守してお取り扱いください。
- 本カタログ記載事項は予告なく変更することがありますので、ご計画に際し詳細は当社宛にお問い合わせください。
- カタログ中「〇〇〇型」の表示は当社の機種記号です。
- 本カタログの内容を無断に転載することを禁じます。



80-001-J29
2020年9月(第4版)SK